

2026 年上半年度 TMT 之科技行业研究：

AI 算力需求持续强劲，景气上行带动利润高增

文/工商部 崔爱巧 张绮含

摘要

2026 年以来，我国半导体产业规模稳步上升，供给端韧性在政策支持与补库存推动下明显改善，结构性分化依然显著；需求侧方面，我国在全球半导体市场中具备一定的规模优势，AI 算力持续作为需求侧增长的核心驱动力，国产替代成效加速显现，但结构性错位仍存在，传统消费电子对整体终端消费及上游半导体增速的贡献正面临压力。产业链上、中、下游议价能力分化明显，竞争总体呈现金字塔格局。2026 年上半年，半导体行业产品价格延续 2025 年下半年启动的结构性景气上行周期，但细分市场分化显著：新能源汽车因车规级芯片成本上涨而被动提价，消费电子则因存储芯片涨价挤压利润、出货量承压。政策方面，2026 年上半年，在外部管制持续的背景下，科技自立自强成为改革主线，国家及地方层面均利好频出，叠加国家集成电路产业投资基金等融资支持的政策组合拳，半导体行业呈现良好发展态势，2026 年一季度半导体行业净利润同比大幅增长。信用层面，资本开支景气上行与科创债政策支持，推动半导体企业债券融资空间扩大，改善信用基本面。展望 2026 年下半年，半导体行业仍位于信用扩张初期阶段，预计信用水平将持续加强，但在需求结构分化与政策动态调整的影响下，行业内部的结构分化态势仍将延续。

一、行业供给能力分析

1.1 行业规模分析

美国半导体协会(SIA)公布的统计数据显示,2025 年全球芯片销售额达到 7,917 亿美元,同比增长 25.6%,创下历史最高年度销售纪录。2026 年 6 月 2 日,世界半导体贸易统计协会(WSTS)宣布,预计 2026 年全球半导体市场规模将达到 1.51 万亿美元,同比增长 90%,这将是全球半导体市场首次突破 1 万亿美元大关。

根据中国半导体行业协会相关数据,2025 年,我国集成电路产业(设计、制造、封测)销售收入超过 1.7 万亿元,同比增长超过 19%,如果加上装备零部件和材料,产业规模实际上超过 1.9 万亿元;且 2026 年 1~2 月,中国集成电路出口金额同比大增 72.6%至 433 亿美元,远超同期全国外贸整体 21.8%的增速,创下近年新高;出口数量则同比增加 13.7%至约 5,250 亿个。据此计算,中国出口芯片的平均单价(ASP)大幅增长约 52%,标志着半导体行业增长逻辑由规模驱动转向价值驱动。随着中国芯片出口的持续增长,分析机构 Omdia 也上调了预测,预

计 2026 年中国半导体市场规模将增长 31.3%，达到 5,465 亿美元。2025 年度，我国半导体上市公司收入规模延续增长的趋势，但增速同比小幅降低。基于中国半导体市场多年来积累的强劲韧性及当下多方面有利因素，预计 2026 年下半年我国半导体市场规模将继续保持增长，但受制于行业周期波动、需求分化及结构性复苏程度不均衡等因素，增速或将放缓。

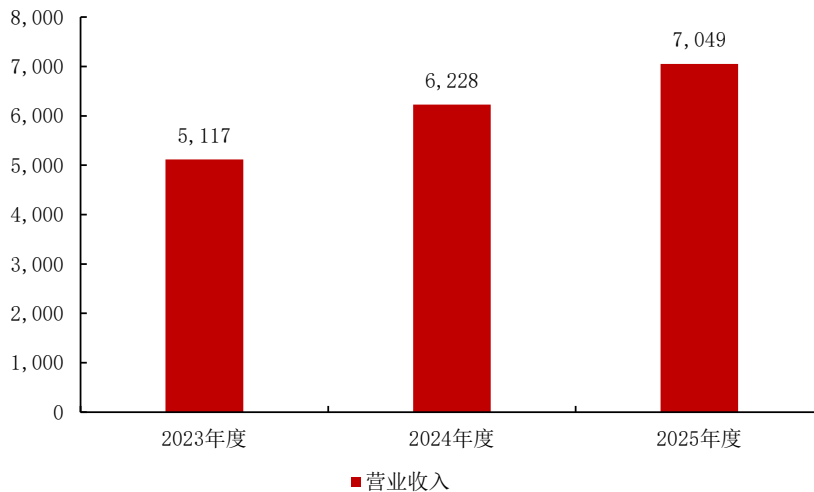


图 1 我国半导体上市公司营业收入（单位：亿元）

数据来源：Wind、大公国际整理

1.2 行业供给结构分析

头部企业集中度方面，国际巨头整体仍占据行业主导地位，但部分细分领域中国企业表现突出。半导体设备方面，2025 年行业排名前五的企业相较 2024 年未发生变化，且营收占据全球前十大半导体设备制造商总营收的 85% 左右。北方华创营业收入排名全球第七，为唯一进入前十的中国企业，另有多家企业新进入前二十名、前三十名，呈现出群体崛起的良好态势。晶圆代工方面，2025 年全球 CR10 合计总产值为 1,695 亿美元，年增 26.3%，创下历史新高。其中，台积电市场占有率达 70.4%，分季度波动较小，持续稳居首位。

中小企业生存状态方面，经营压力逐渐扩大，马太效应持续凸显，普遍表现为“增收不增利”。从盈利能力上看，2025 年亏损面整体占比下行，行业发展态势向好，但部分中小企业的利润增速持续下降，盈利能力已开始承压。从融资进程上看，2025 年半导体领域融资规模与活跃度均呈回升态势，成为资本布局重点，其中，AI 领域尤其是机器人和工业 AI 方向的资本投入增长明显，为相关企业带来融资机会；而芯片半导体领域整体投融资呈现“量增价减”态势，资金结构上呈现“头部集中与长尾繁荣并存”的特征：占比 3% 头部独角兽吸纳近四分之一融资额，而近九成的长尾创业公司合计获得 55% 融资额，资本在产业链各细分环节广泛布局。

产能利用率方面，受晶圆大厂减产及 AI 基础设施建设等影响，成熟制程总体产能利用率显著提高，代工价格止跌上涨，预计延续至 2027 年上半年，先进制程总体产能利用率全线满载，存储芯片进入新一轮超级上升周期，产能利用率进一步攀升。国内市场方面，由于部分晶圆代工业者移转产能、调涨价格，转单效应自 2025 年下半年开始显现，带动中国大陆厂商成

熟制程订单增长。但受政策支持和国产替代需求增加影响，国内成熟制程产能增加较快，使得产能利用率存在下行压力，或将出现结构性过剩情形，先进制程等产能扩张困难。

1.3 行业供给韧性评估

2026 年以来，受境外需求增加、国内政策支持及内部补库存等影响，国内半导体行业供给侧韧性增强，但仍分化明显。国内作为主要的成熟制程代工基地，具备一定抵御外部冲击能力，基于客户需求和在手订单情况，中芯国际表示 2026 年以来的整体运营情况相较上一季度更加乐观。但需警惕这种韧性增加主要来源于 AI 等特定细分领域需求，消费电子等领域需求仍疲软，叠加地缘政治等因素，需关注长期韧性保持潜力。

二、行业需求匹配能力分析

2.1 行业总体需求能力分析

2026 年 1~4 月，全球半导体行业销售额及我国半导体行业销售额分别以 70.44%、64.37% 的速度继续增长，我国半导体销售额占全球的比重为 26.76%，占比超过四分之一，表明世界半导体增量高度依赖中国市场，我国在全球半导体市场中具备一定的规模优势。但需要注意的是，我国半导体行业增速仍低于全球约 6 个百分点，侧面反映出产品仍以成熟制程为主，先进制程产品受限，结构性过剩与高端产能不足并存；AI 增长红利相较全球市场获取不足，国内厂商在产品性能、软件生态及高端训练场景中的竞争力尚不均衡，结构性错位问题依然存在。

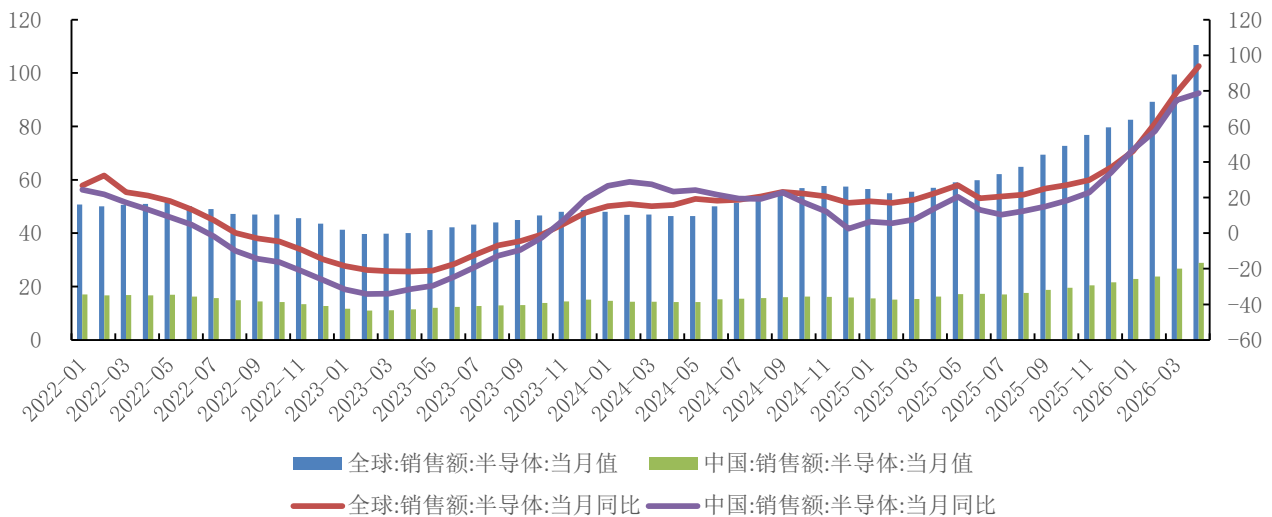


图 2 全球和我国半导体销售额及同比变化 (单位: 十亿美元、%)

数据来源: Wind、大公国际整理

(1) 算力

2025 年全球算力总规模已达 2.1 ZFLOPS (10^{21} 次/秒)，智能算力占比达 75%；2026 年上半年，全球算力规模延续爆发式增长态势。此外，据中国信通院数据，预计 2030 年全球算力总规模将超过 50 ZFLOPS，智能算力占比突破 95%，行业正从传统云时代全面迈入 AI 智算时代。

根据工业和信息化部等六部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，我国算力基础设施建设持续加速。截至 2026 年 3 月末，我国智能算力规模已达 1,882 EFLOPS (FP16)，位居全球前列；在用算力中心标准机架达 1,445 万架，全国一体化算力网监测调度平台已接入全国约七成智能计算资源。赛迪研究院预计，2026 年我国智能算力占比有望突破 35%。

推理需求的崛起持续带动算力需求爆发。2026 年以来，国内 AI 算力市场进入结构化阶段，推理算力需求已占全部 AI 计算的三分之二以上；TrendForce 数据显示，北美五大 CSP 2026 年 AI 推理算力预计将暴增 122%，增速是训练算力的两倍以上。随着算力互联互通体系加速建设，不同区域、主体的算力资源实现标准化互联，AI 应用部署门槛持续降低；国产算力芯片规模化商用进程加快，算力供给成本趋于下降，进一步释放了部分 AI 算力需求。AI 算力作为需求侧增长的核心驱动力地位持续巩固，国产替代成效加速显现。

(2) 消费电子

2025 年，在国补政策刺激、AI 功能迭代及设备更新需求释放等多重因素推动下，传统消费电子销售额实现明显增长，其中，手机品类受益于补贴力度与换机周期共振，增长弹性显著优于笔记本电脑。

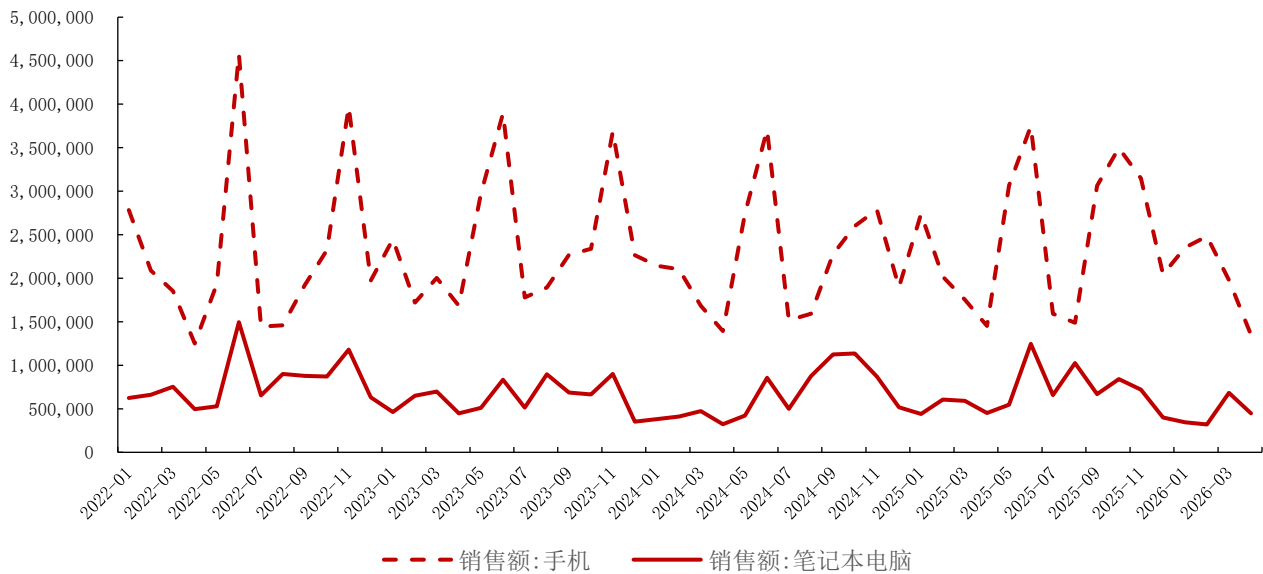


图 3 我国手机、笔记本电脑销售额 (单位: 万元)

数据来源: Wind、大公国际整理

进入 2026 年，趋势发生明显转变，2026 年 1~4 月，手机累计销售额约 816.22 亿元，较 2025 年同期的 896.60 亿元下降 8.97%；笔记本电脑累计销售额约 179.40 亿元，较 2025 年同期的 209.72 亿元下降 14.46%，存储芯片等核心元器件缺货推动成本上涨，通过价格传导抑制了终端消费需求；同时，设备更新窗口期红利消退，传统消费电子对整体终端消费及上游半导体增速的贡献正面临压力。

展望 2026 年下半年，以 AI 眼镜、AI 穿戴/耳机、智能家居等为代表的新兴 AI 终端需求正快速提升，细分领域景气度将出现明显分化。传统消费电子整体或步入中低速甚至负增长区

间，而具备 AI 交互与场景创新属性的新兴硬件有望成为结构性增量来源，驱动消费电子产业链进入“存量替代与增量突破”并行的新阶段。

(3) 工业电子

2026 年 1~5 月，我国新能源汽车销量同比增长 3.52%，增速较上年同期明显收窄，需求扩张步伐显著放缓。单月看，1 月销量同比微增 0.11%，基本持平；2 月受春节及政策退坡滞后影响，同比下滑 14.23%，拖累整体表现；3~5 月虽恢复正增长，但月均增幅仅约 8.5%，远低于 2025 年同期的爆发式增长。

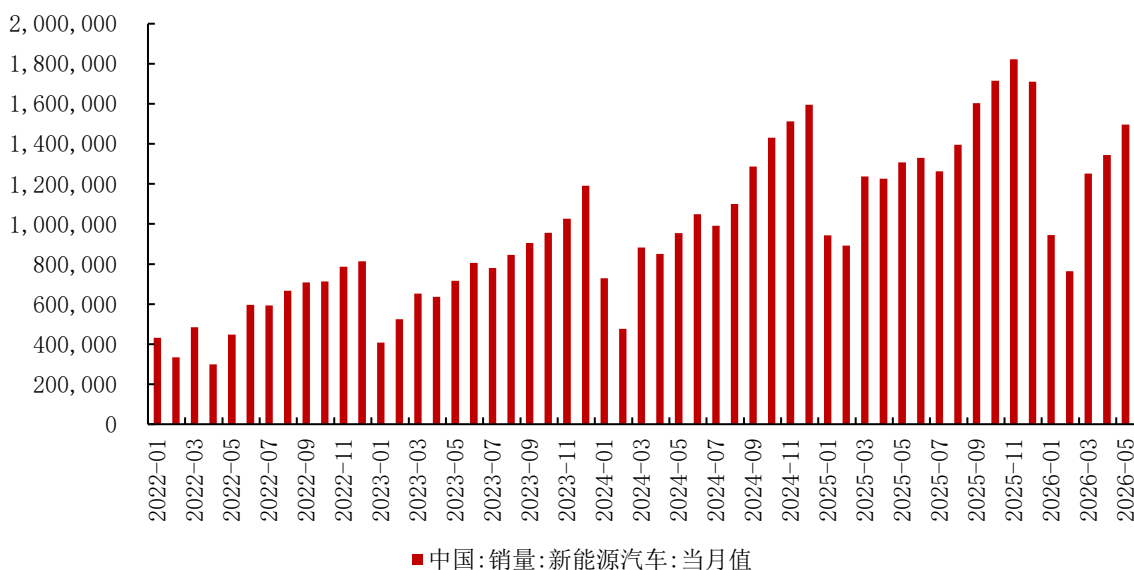


图 4 我国新能源汽车销量 (单位: 辆)

数据来源: Wind、大公国际整理

根据《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，2025 年为购置税免征政策最后窗口期，此前市场普遍预期 2026 年将出现明显需求滑坡，实际增速虽略好于部分悲观预测，但政策退出带来的消费前置效应已明显体现，且 2 月单月深度下滑表明透支消化压力犹存。后续需密切关注 2026 年下半年销量环比走势、终端库存累积情况以及产业链（电池、零部件）排产和利润空间的承压程度，警惕行业增速由高位向中低速过渡过程中的结构性调整风险。

2.2 行业需求结构变化分析

2026 年上半年，我国半导体终端客户呈现清晰的分层特征，高端市场以技术引领、高度定制为主，集中于 AI 服务器、智驾及折叠旗舰；中端市场注重性价比与迭代速度，体现在主流新能源汽车与智能家居领域；基础市场则以满足功能、价格优先为特征。高端市场方面，受 AI 算力需求拉动，高性能 AI 芯片及电源管理 IC、功率器件等配套芯片的需求涨势强劲。同时，智能驾驶技术向高中低端车型加速下沉以及舱驾融合芯片等新形态产品的落地，共同推动智驾芯片需求延续增长。中端市场方面，新能源汽车渗透率持续高位运行，市场逐步向存量竞争与

结构升级切换，长期来看依赖电动化迭代和海外出口作为支撑。基础市场方面，燃油车与消费电子的疲弱态势造成了结构性压力。整体而言，行业供需关系由此前的需求结构切换，逐步体现为不同技术层级、不同应用场景之间的结构性差异，供给端产能利用率分化格局持续存在。

2.3 行业供需平衡分析

2026 年以来，我国半导体行业供需平衡继续呈现明显分化态势，结构性供需矛盾在不同细分市场和技术层级间持续显现。

基础市场供给出现收紧现象，但仍存在结构性分化。伴随全球生产格局变化，海外订单向国内转移，成熟制程与通用芯片产能利用率将近满载，但涨价在不同制程与品类间分化明显，八英寸及部分功率相关制程供需趋紧、价格上行，而十二英寸成熟制程受消费电子疲弱拖累，动能相对受限，中低端产品去库存进程仍较缓慢。

中端市场的技术迭代继续受到 AI 相关需求的影响，AI 服务器等领域保持高速增长，推动中端存储芯片及部分专用芯片需求持续走强，供给呈现阶段性紧张，而其他通用终端芯片受到消费电子需求相对平稳的影响，供给总体上较为稳定。

高端市场方面，市场供需仍偏紧，先进制程与高端存储等高附加值芯片需求持续旺盛，可供产能依然受限。三大原厂（三星、SK 海力士、美光）HBM 产能 2026 年已全部售罄，核心客户锁定至 2028 年，产能缺口高达 50%~60%。尽管国内企业在 GPU 等高端芯片领域取得阶段性进展，但高端技术国产化的进展尚不足以显著缓解供需矛盾。同时，受制于技术与国际供应链限制，高端芯片的供需失衡仍然存在，短期内难以得到根本缓解。当前国内先进工艺制程的产能利用主要集中在满足 AI、高性能计算等高端需求，其他市场参与者在技术与产能匹配上仍面临较大挑战。

三、行业的产业链地位分析

半导体产业链结构复杂、紧密相连，具体分为上游（材料、设备）、中游（设计、制造、封测）和下游（应用）三部分。

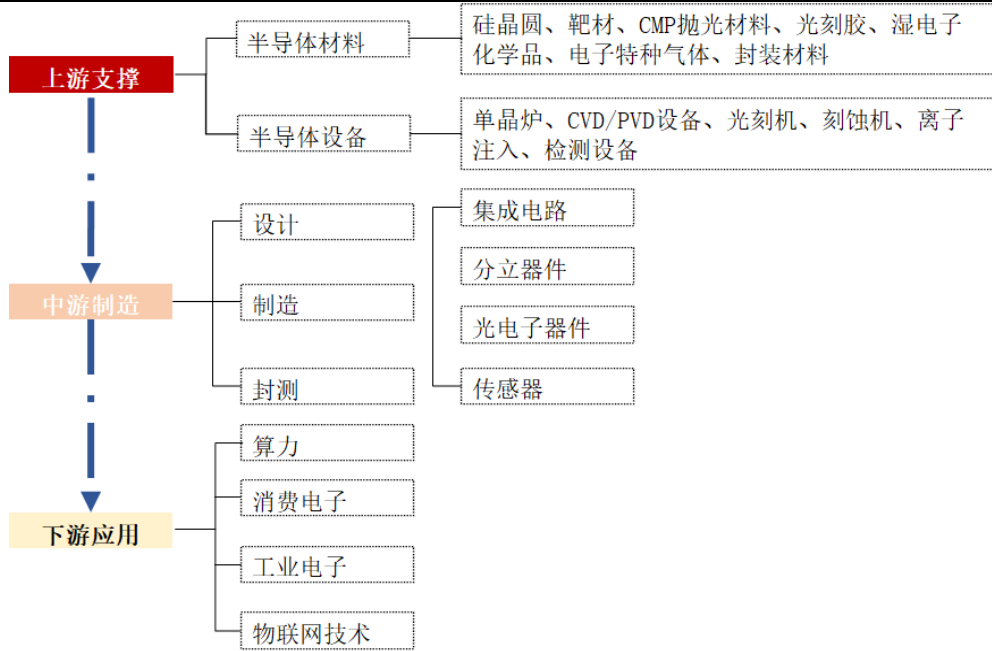


图5 我国半导体产业链

数据来源：公开资料、大公国际整理

3.1 行业纵向议价能力分析

上游供应商议价能力极强，技术门槛极高。半导体设备方面，光刻机等核心设备被 ASML 等少数企业垄断，使其具备极强的议价能力。半导体材料方面，硅片、光掩模等全球集中供应，替代难度大，进一步强化了上游议价能力。但在成熟制程领域，由于下游代工厂面临激烈的市场竞争与成本压力，正积极向上游材料、化学品等供应商转嫁成本要求降价，使上游部分环节的议价能力受到一定程度的挤压。

中游半导体企业议价能力分化明显。代工方面，台积电凭借超 70% 的全球市占率，在先进制程上定价能力极强，但三星正以低约 33% 的报价争夺 2nm 级客户，先进制程代工定价并非绝对垄断。设计方面，成熟工艺技术壁垒不高，上游依赖代工厂产能，下游客户集中度高，双头挤压其盈利空间，导致议价能力较弱但部分具备产品竞争力或细分市场优势的企业（如联发科、瑞昱等）已启动涨价，展现出一定的成本转嫁能力。而具有高级知识产权模块的企业虽仍具较强市场竞争力，但在 AI 芯片供给增加、租赁价格回落的背景下，其议价能力已出现松动迹象，定价权面临一定挑战。

下游客户议价能力受限。消费电子、汽车电子等终端客户方面，虽然企业订单量足够大使其具备对上游较强议价能力，但高端芯片成本之高又对议价能力形成牵制，此外，存储芯片等关键零部件价格的持续上涨，也进一步侵蚀了终端客户的利润空间，压缩了其向上游的议价能力。AI 芯片客户方面，因采购量大和定制需求高等特点，对上游的设计企业有较强压价能力，但对高端 AI 芯片需求刚性，又使其议价空间受限。

3.2 行业内部竞争格局分析

半导体行业总体特征为多层次、梯队化、快速演进，金字塔竞争格局清晰。内部竞争特点主要体现为以下两点：一是技术节点差距决定盈利分层，不同技术含量的芯片毛利率差距较大；二是需求多点爆发，芯片随下游市场变化表现需求程度不同。在政策和整合需求推动下，半导体行业整体并购进程持续加速，横向整合扩充产能规模、纵向并购完善产业链协同成为产业发展主流趋势。仅 2026 年 1 月，相关并购事件就超过 45 起，占开年总并购量的近五分之一，其中包含大额并购多起，市场集中度有望继续提升。但考虑到上一年度半导体收购交易因估值分歧、业绩不达预期及监管趋严等原因频现终止，预计 2026 年资本市场将在谨慎估值的基础上稳健投资。行业内部竞争格局整体仍呈现“高端紧缺、中游分化、低端内卷”的态势，产业链各环节因技术壁垒与市场地位高度分化，国产替代与技术突围仍是行业发展的核心任务。

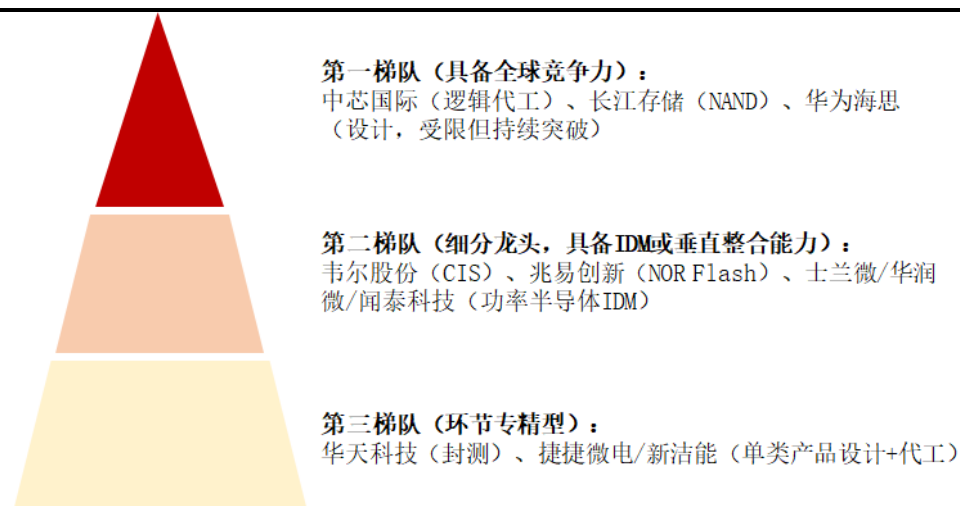


图 6 我国半导体行业竞争格局

数据来源：公开资料、大公国际整理

3.3 行业价格波动分析

2026 年上半年，半导体行业产品价格延续自 2025 年下半年开启的上行周期，涨幅持续扩大，存储芯片领涨，成熟制程代工价格亦整体回升，但细分市场分化显著：新能源汽车受上游存储涨价传导被迫提价，消费电子则因需求乏力出货承压。价格波动和驱动因素主要如下：一是产能挤占，AI 算力需求持续挤占 DRAM 及 NAND Flash 常规产能，致使供应陷入结构性紧缺，其中汽车端受 AI 排挤显著，2026 年 3~6 月，车规级存储芯片价格上涨约 180%，并进一步带动终端价格上涨，而消费电子端需求乏力，出货量相应减少。二是成本端，上游原材料持续涨价的压力正沿产业链逐级传导，硅片环节率先提价，带动下游晶圆代工端进入全面涨价阶段。三是全球产业链调整，随着海外头部晶圆厂逐步关闭 8 英寸产能，12 英寸成熟制程长期供需将收紧，带动价格进一步回升，先进制程摊销费用拉高高端芯片基础价格。四是地缘政治，美国对华半导体出口管制持续收紧，2026 年上半年新增多家中国企业至实体清单，高端芯片国产替代节奏不断加速；后续需警惕地缘政治升级带来的供应链稳定性下降、技术合作与人才流

动受限、贸易及关税壁垒抬升成本等多重不利影响，上述或将加剧整体行业短期内的不确定波动。五是库存周期，2025 年上半年行业处于去库存中后期，部分品类库存仍偏高，进入 2025 年第四季度，AI 需求爆发驱动去库存加速，2026 年初，三大存储原厂 DRAM 库存已降至约四至六周的正常水位，其中 SK 海力士库存处于历史低位；受供求关系影响，价格上涨。

四、行业创新能力分析

4.1 政策导向分析

政策导向方面，国家层面，2026 年 1 月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发〔2025〕11 号），明确了到 2027 年率先实现人工智能与 6 大重点领域广泛深度融合的发展目标，并提出加快形成智能经济和智能社会新形态。同期，工业和信息化部等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，明确要求突破关键硬件技术瓶颈，加快算力基础设施及平台建设，进一步强化人工智能算力供给能力。2026 年 3 月，十四届全国人大四次会议审议批准了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，确立未来五年的行动纲领，要求“全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破”，重点布局人工智能、量子科技、生物科技、新能源等前沿科技领域。同时，2026 年政府工作报告进一步强调“加紧培育壮大新动能”，首次提出“打造智能经济新形态”，并部署实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程。2026 年 6 月，工业和信息化部办公厅发布关于组织开展 6G 创新发展部省协同试点专项行动的通知，明确提出加强新型终端、芯片器件、操作系统、商业航天等 6G 关联产业培育，打造地方 6G 特色产业集群。地方层面，各地积极响应国家政策，结合区域产业优势与资源助推半导体相关产业发展，2026 年 1 月，上海市政府印发《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案（2026—2028 年）》，明确提出支持集成电路企业瞄准装备、先进工艺、光刻胶材料、3D 封装，实现全产业链突破，培育一批具有国际竞争力的龙头企业。同期，深圳市福田区出台《深圳市福田区支持半导体与集成电路产业集群发展若干措施》，围绕中高端芯片产品突破、芯片设计流片、EDA 和 IP 工具应用、产业链关键环节突破、产业供应链发展、企业融资支持等八大方向构建全链条政策支持体系。广州市南沙区发布《促进半导体与集成电路产业高质量发展扶持办法》，对总投资超 1 亿元的半导体重大项目按设备实际投入的 10% 给予补贴，最高可达 2 亿元。2026 年 1 月，北京市以建设全球人工智能创新高地为目标，通过实施九大专项行动，初步形成智能经济新形态，成为具有技术策源力、产业竞争力的全球人工智能创新高地。2026 年 2 月，北京市发布 2026 年高精尖产业发展项目资金实施指南，将集成电路设计产品首轮流片等 24 个方向列为重点支持领域，单个企业最高可获 3,000 万元奖励。

财税优惠方面，在集成电路产业方面，根据有关规定，符合条件的 28nm（含）及以下企业享受十年免税，65nm（含）及以下和 130nm（含）及以下企业分别享受“五免五减半”和“两免三减半”优惠，进口关税减免覆盖关键零部件。

企业融资方面，2026 年初，国家集成电路产业投资基金三期（以下简称“大基金三期”）进入出资高峰期，大基金三期注册资本达 3,440 亿元，体量超越前两期总和，首次引入工商银行、建设银行等六大国有银行逾 1,000 亿元资金。2026 年 1 月，大基金三期与华芯投资共同出资成立华芯鼎新（北京）股权投资基金，出资额 930.93 亿元，首批投资项目聚焦先进封装及 3D 集成设备、车规级功率半导体及数模混合制造平台两大方向，反映出投资逻辑从“规模扩张”向“技术自主、系统补链”的精准化转向。此外，由工业和信息化部、财政部牵头总规模 600.6 亿元的国家人工智能产业投资基金于 2026 年 1 月正式启动运行，已落地投资云脉芯联等 AI 算力网络芯片企业。

标准制定方面，2025 年第四季度，我国在 5G、半导体等关键科技领域主导发布了 38 项国际标准，在量子、AI 等前沿方向提出 60 项新提案。同时，市场监管总局即将牵头启动“人工智能百项国家标准建设专项行动”，推动产业进一步规范。

算力基础设施方面，2026 年 2 月，工业和信息化部发布《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，提出建立“1+M+N”国家算力互联互通节点体系，通过统一标识、统一标准、统一规则实现不同区域、主体、架构的算力资源标准化互联和高效流动应用。2026 年 3 月，工业和信息化部启动 2026 年度城域“毫秒用算”专项行动，拟在 50 个地区开展专项行动，提升算力高效运载能力。2026 年 4 月，工业和信息化部启动普惠算力赋能中小企业发展专项行动，提出到 2028 年底基本建成覆盖广、成本低、服务优的普惠算力服务体系，并创新“算力银行”、“算力超市”等业务模式，支持中小企业按“卡时”、“核时”及 Token 计费等多元化方式灵活付费。

国际动态方面，2026 年 1 月，美国商务部工业和安全局（BIS）修订对华出口特定半导体产品许可审查政策，将原先的“推定拒绝”改为“个案审查”，涵盖英伟达 H200 及其同类产品。2026 年 4 月，BIS 进一步扩大实体清单，新增 140 家中国企业，涉及半导体设备制造商、零部件供应商和材料公司。同期，美国国会两党议员提出《硬件技术控制多边协调法案》（MATCH 法案），旨在进一步扩大对中国半导体设备及零部件的出口管制范围并强化多边协调。2026 年 5 月，BIS 发布新规，规定即便相关实体位于中国境外，只要其总部设在中国，美国仍将对向其出口先进芯片实施许可证要求。

热点事件方面，2026 年 1 月，士兰微电子国内首条 8 英寸碳化硅功率器件芯片生产线实现通线，该生产线拥有自主知识产权，标志着公司在第三代半导体领域完成了从技术突破到规模化交付的关键跨越，对加快高端芯片国产化替代、提升供应链韧性具有重要意义。2026 年 3 月，全球半导体行业年度盛会 SEMICON China 2026 在上海举办，北方华创、中微公司等国产设备龙头密集发布新产品，吸引了市场的高度关注。2026 年 5 月，华为在 IEEE 国际电路与系统研讨会上正式发布半导体“ τ 定律”，在器件、电路、芯片到系统层面做到多层协同优化，为半导体产业提供新的发展路径，有助于突破传统制程依赖，实现芯片自主可控。同期，半导体行业头部并购密集落地，三家龙头企业各以不同整合路径推进资产重组，合计交易规模

超 540 亿元：中芯国际以约 406.01 亿元收购中芯北方剩余 49% 股权实现全资控股，为科创板设立至今交易规模最大的发行股份购买资产交易，也是国产晶圆代工行业历史上金额最大的并购案。华虹公司拟以约 82.68 亿元收购华力微 97.5% 股权，实质解决 65/55nm、40nm 产线的同业竞争问题。中微公司以发行股份及支付现金方式收购杭州众硅 64.69% 股权，复牌当日股价大涨 14.16%，以拓展 CMP 设备能力。截至 2026 年 5 月末，中微公司对杭州众硅的收购已完成资产过户手续。2026 年 5 月，国内 DRAM 龙头长鑫科技科创板 IPO 成功过会，拟募资 295 亿元，为 2026 年以来 A 股最大 IPO 项目，也是科创板历史上规模最大的半导体 IPO 项目之一；按产能和出货量统计，长鑫科技已成为中国第一、全球第四的 DRAM 厂商。2026 年 6 月，宇树科技仅用 73 天科创板过会，为继长鑫科技之后科创板预先审阅机制落地后的第二单标杆案例，冲刺 A 股“具身智能第一股”。

4.2 技术创新能力分析

2025 年度，半导体板块的营业收入（平均值）继续同比增长，研发费用（平均值）同比有所下降，但行业整体仍处于高投入阶段，预计短期内研发投入仍处于较高水平，长期内随着技术瓶颈突破、订单持续放量，盈利能力将逐步释放。从 A 股市场来看，2026 年一季度，半导体行业合计实现净利润近 254 亿元，同比增长近 180%，增幅同期增加 140 个百分点以上。

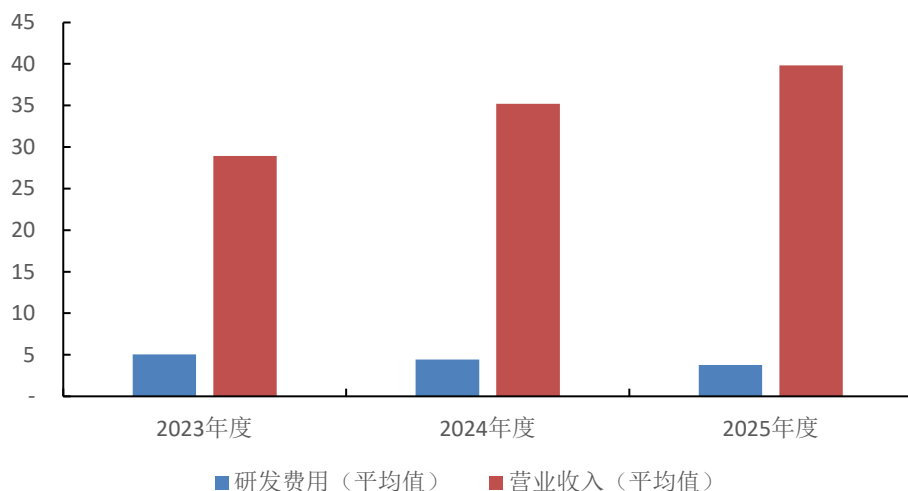


图 7 半导体上市公司 2023~2025 年研发费用、营业收入（单位：亿元）

数据来源：Wind、大公国际整理

半导体行业的技术创新以持续高强度的研发投入为基石，沿着三条主线同步推进，一是前沿技术攻坚，聚焦关键领域薄弱环节进行突破，例如在 12 英寸碳化硅 (SiC) 衬底及设备领域实现从“点状突破”到“链式协同”，以及在光刻胶、电子特气等关键材料上持续取得进展，加快构建自主可控能力；二是市场需求牵引，AI 等领域的强劲需求，驱动行业创新向中高端领域迈进；三是战略收缩与聚焦，行业巨头通过剥离非核心或低增长业务来优化资源配置，标志着行业更加注重投资回报与核心优势。短期内，半导体行业创新的增长引擎主要在服务于 AI 与先进制程的逻辑及存储芯片领域，而长期的产业竞争力，则将取决于在新材料、新架构等领

域的技术突破速度。行业正从广泛的战略布局转向聚焦核心竞争力的精耕细作阶段。

五、行业信用评级情况分析

从发债规模来看，2026 年以来，截至 2026 年 6 月 17 日，半导体行业发债规模合计 221.54 亿元，共计 22 只，2025 年全年发行规模为 195.22 亿元，发行只数为 26 只，2026 年不到半年时间，半导体发债规模已超过 2025 年全年，表明半导体企业通过债券市场融资的意愿和能力明显增强，随着资本开支进入高景气阶段、国产替代和先进产能建设进程加速落地，债券扩容正在加速，预计未来半导体企业在债券市场融资的开拓空间将继续增大。

从债券类型来看，以私募公司债和一般中期票据为主，一方面表明企业看重融资的速度和便捷性，在行业关键发展期，以最快速度获得资金用于及时补充流动资金、偿还贷款或项目建设；另一方面，在科创债政策支持下，半导体龙头企业利用当前有利的利率窗口，为自身的长期发展进行一次战略性的融资布局，所发行的 6 只中期票据中，4 只为科创债券，此外，所发行的 3 只可转债均为科创债券。从债券期限来看，以偏长期（5~10 年）为主，偏长期意味着低成本，并有意匹配技术爬坡周期。

表 1 2026 年以来半导体行业信用债发行情况

类型	规模 (亿元)	只数 (只)
公司债 (证监会)	116.58	12
其中: 私募公司债	66.70	9
可转债	49.88	3
债务融资工具	78.90	8
其中: 一般中期票据	69.00	6
超短期融资券	9.90	2
资产支持证券	26.06	2
其中: 交易商协会 ABN	26.06	2
合计	221.54	22

数据来源: Wind, 大公国际整理

发行利差方面，半导体行业 2026 年以来整体发债仍较少，以发债规模最大的 AAA 级别为例，期限为 10 年、5 年、3 年和 1 年的利差分别为 26.89bp、39.66bp、42.40bp 和 26.83bp，由于半导体行业发行的超短期融资券期限均为 0.7397 年，国债到期收益率使用 1 年期利率，故超短期融资券的利差跨度偏小，剔除上述因素，整体来看，半导体行业各期限债券的发行利差与发行主体的发债期限基本呈现负相关关系。

六、周期发展展望

需求端，2026 年上半年全球半导体需求结构呈现高度分化的“AI 拉动”与“消费承压”并存格局。其中，以 AI 服务器与存储芯片为代表的算力相关需求已成为不可逆的全局增长引擎。新能源汽车销量增速放缓，转向存量结构化升级，消费电子领域持续承压。供给端，2026

年上半年，全球成熟制程供给端迎来“量缩价涨”的深刻重构，国内晶圆厂正处于近年来最有利的供需格局中，我国在成熟制程领域的产能优势将进一步确立。

产能出清方面，2026 年上半年，我国半导体行业在国产替代持续深化和供应链自主可控加速推进的背景下，并购整合持续活跃，低效产能同步出清。产业资源正向具备核心竞争力的优质企业加速集中，整合重点从规模扩张转向产业协同与核心竞争力构建，行业整体正在迈入以质量与效能为主导的新阶段。

盈利方面，2026 年一季度，半导体板块的盈利提升显著，产业整体在 AI 驱动下进入盈利大幅释放阶段，数字芯片设计、半导体设备、封测等环节皆呈现量价齐升格局。但成熟制程产能利用率虽高，因折旧成本压力与消费电子终端需求偏弱叠加，盈利修复节奏较 AI 链条仍明显滞后。

展望 2026 年，半导体行业仍位于信用扩张初期阶段，预计信用水平将持续加强，并在需求结构变化和政策边际调整影响下继续呈现结构性分化特征。

报告声明

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为大公国际，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。